

Series: **多層プリント配線板**

Type: **多層プリント配線板**

表裏の導電層の他、内層にも導電層を形成し、かつ各々の層を銅めっきで接続したプリント配線板
工業所有権；特許 8件登録

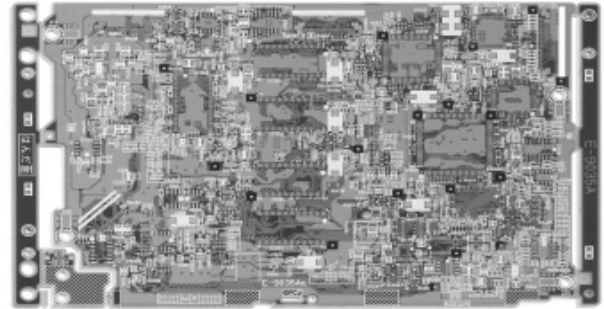
Type: **IVH付多層プリント配線板**

チップランド等の下に非貫通のビアホールを設けることにより、層間を電氣的に接続した多層プリント配線板
工業所有権；特許 5件登録

Type: **ビルドアッププリント配線板**

めっき、プリントなどによって順次絶縁層、導電層を積み上げていく製法(ビルドアップ法)による多層プリント配線板

Japan
China
Taiwan
Thailand



■ 特長

- 高精度面実装に対応
- 貫通スルーホール(の減少で基板面積削減)
- 配線長の短縮によるノイズの低減
- RoHS対応(但し、鉛はんだレベラー処理製品を除く)

■ 主な用途

- ノートパソコン、携帯電話
- ビデオカメラ、デジタルスチルカメラ
- デジタルTV、STB、DVDレコーダー
- 車載機器

■ 取得規格

UL規格 (File No. E36779)

●Type: 多層及びIVH付多層プリント配線板

生産地	UL品番	難燃性	基 材		導 体			はんだ付け 定格 (°C), (秒)	定格温度 (°C)
			ANSI Grade	最小導体幅 (mm)	最小エッジ 導体幅 (mm)	最大導体幅 (mm)			
日本	EMMM1	94V-0	FR-4	0.05	0.15	152	260, 20	105	
	EMMM2	94V-0	FR-4	0.05	0.15	50.8		130	
中国,台湾 タイ	EMMM4	94V-0	FR-4	0.03	0.03	25.4	288, 12	130	

詳細については仕様により異なりますので、お問い合わせください

上表の数値はUL取得内容であり、設計を示す数値ではありません。

●Type: ハロゲンフリー対応

生産地	UL品番	難燃性	基 材		導 体			はんだ付け 定格 (°C), (秒)	定格温度 (°C)
			ANSI Grade	最小導体幅 (mm)	最小エッジ 導体幅 (mm)	最大導体幅 (mm)			
日本	EMMM3	94V-0	FR-4	0.05	0.15	50.8	260, 20	130	

上表の数値はUL取得内容であり、設計を示す数値ではありません。

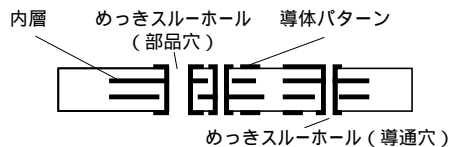
●Type: ビルドアッププリント配線板

生産地	UL品番	難燃性	基 材		導 体			はんだ付け 定格 (°C), (秒)	定格温度 (°C)
			ANSI Grade	最小導体幅 (mm)	最小エッジ 導体幅 (mm)	最大導体幅 (mm)			
日本	EMMM5	94V-0	—	0.05	0.05	20	260, 20	105	
台湾	EMXM1	94V-0	—	0.09	0.09	76.2		105	

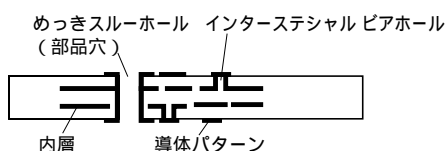
上表の数値はUL取得内容であり、設計を示す数値ではありません。

■ 構造図

●Type: 多層プリント配線板



●Type: IVH付多層プリント配線板



●Type: ビルドアッププリント配線板

